



中华人民共和国国家军用标准

FL 6124

GJB 8121-2013

半导体光电组件通用规范

General specification for semiconductor optoelectronic assembly

2013-07-10 发布

2013-10-01 实施

中国人民解放军总装备部 批准

目 次

| | |
|------------------------|----|
| 前言 | II |
| 1 范围 | 1 |
| 2 引用文件 | 1 |
| 3 要求 | 1 |
| 3.1 总则 | 1 |
| 3.2 材料和元器件 | 1 |
| 3.3 设计和结构 | 2 |
| 3.4 绝对最大额定值 | 2 |
| 3.5 性能 | 2 |
| 3.6 环境适应性 | 2 |
| 3.7 安全性 | 2 |
| 3.8 电磁兼容性 | 3 |
| 3.9 维修性(适用时) | 3 |
| 3.10 标志 | 3 |
| 3.11 MTBF(规定时) | 4 |
| 3.12 加工质量 | 4 |
| 4 质量保证规定 | 4 |
| 4.1 检验分类 | 4 |
| 4.2 检验批的构成 | 4 |
| 4.3 样品的处理 | 4 |
| 4.4 筛选 | 5 |
| 4.5 鉴定检验 | 6 |
| 4.6 质量一致性检验 | 6 |
| 4.7 不合格批的重新提交 | 8 |
| 4.8 试验设备故障或操作人员差错引起的失效 | 8 |
| 4.9 组件存放超过 36 个月的程序 | 8 |
| 4.10 检验和试验方法 | 8 |
| 5 交货准备 | 9 |
| 5.1 包装 | 9 |
| 5.2 储存 | 10 |
| 5.3 运输 | 10 |
| 6 说明事项 | 10 |
| 6.1 预定用途 | 10 |
| 6.2 分类 | 10 |
| 6.3 订货文件内容 | 10 |
| 6.4 术语和定义 | 10 |
| 6.5 环保材料 | 10 |

前 言

本规范由中国人民解放军总装备部电子信息基础部提出。

本规范起草单位：工业和信息化部电子第四研究所。

本规范主要起草人：赵 英、陈 兰。